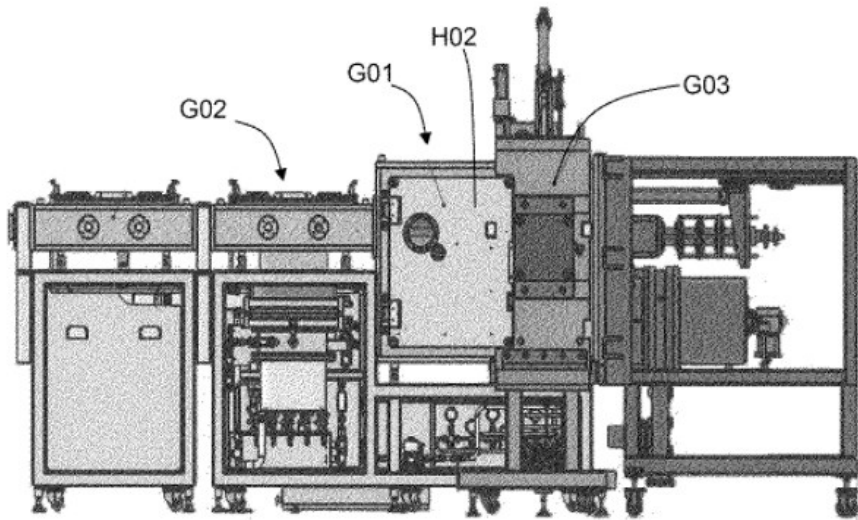


発明の名称	接合基板作製方法、基板接合方法、及び接合基板作製装置		
出願人/権利人	須賀 唯知、ボンデック株式会社、太陽誘電株式会社、ランテクニカルサービス株式会社	発明者	須賀 唯知、山内 朗、近藤 龍一、松本 好家
出願日	平成24年1月30日	出願番号	2012-555849
公開番号	WO2012/105473	特許番号	6163689
法的状態	登録中		

代表図



G 0 1 接合基板作製装置 G 0 2 ロードロック装置
G 0 3 基板接合装置 H 0 2 プロセス室

発明の概要

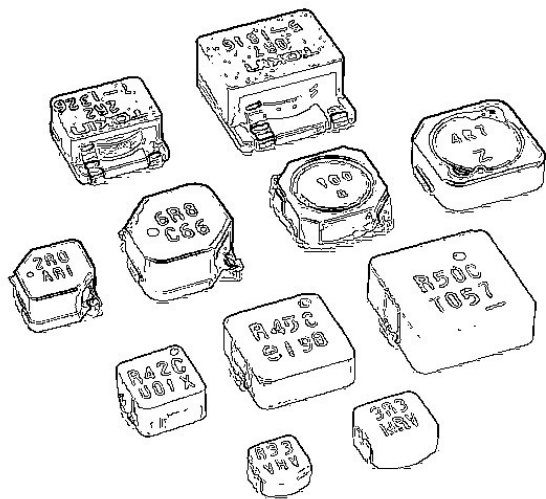
基板同士を接合する接合技術とその装置

特徴

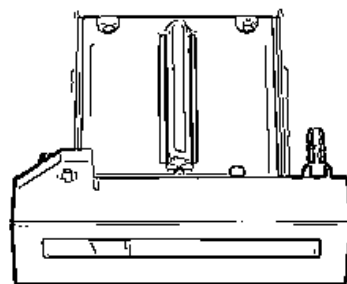
本発明は、加熱処理を伴う接合や常温接合におけるシビアな接合環境要件を緩和し、改良された基板接合技術を提供する。

具体的には、接合時の雰囲気が高真空でなくとも、十分な接合強度を担保する接合面を形成する接合基板の作製方法とそれにより作製された基板接合体を提供する。さらに、十分な接合強度のポテンシャルを有する接合面を有する接合用基板を作製するとともに、表面処理をするプロセス室と接合機構とを個別柔軟に配置することができる装置を提供する。

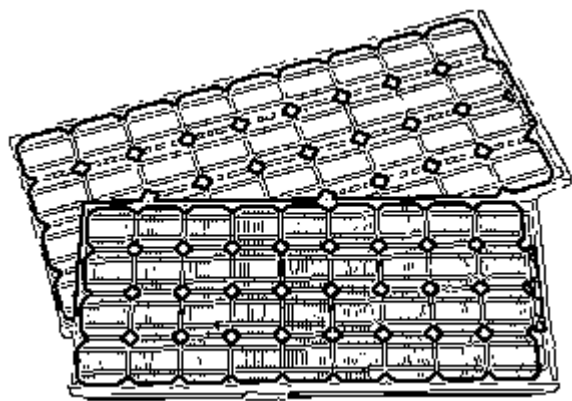
応用の可能性



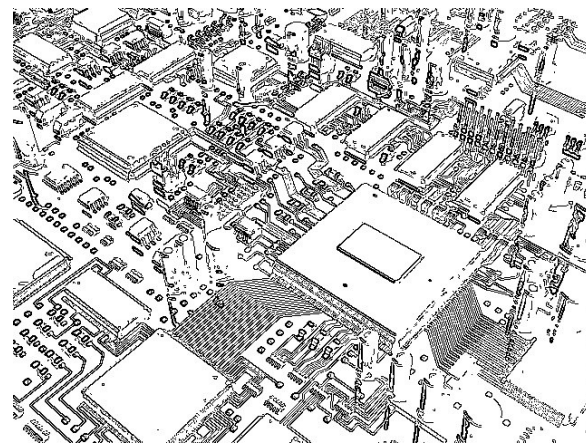
電気製品に用いられる磁性素子



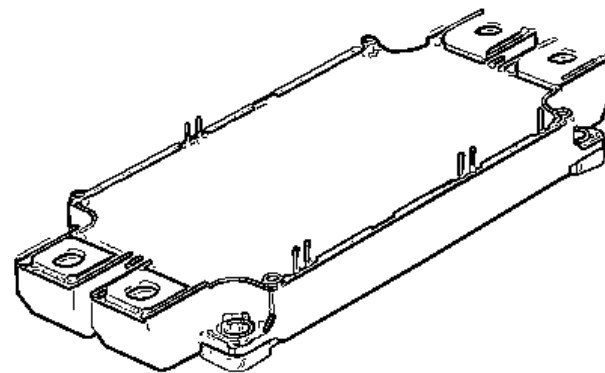
液滴吐出ヘッド



太陽電池



半導体式センサ



パワーモジュール

など

応用の可能性

- ・液滴吐出ヘッド
- ・電気製品に用いられる磁性素子
- ・パワーモジュール
- ・太陽電池
- ・半導体式センサ など

本技術の活用が見込める企業の一例

- ・セイコーエプソン株式会社
- ・住友ベークライト株式会社
- ・富士フイルム株式会社
- ・スミダコーポレーション株式会社
- ・三菱電機株式会社
- ・DOWAホールディングス株式会社
- ・NTTエレクトロニクス株式会社
- ・株式会社デンソー など

権利人の本発明に関する最新動向

- ・ボンドテック株式会社のホームページに表面活性化による常温接合プロセスについての説明有り (<http://www.bondtech.co.jp/technology.html>)。
- ・ランテクニカルサービス株式会社のホームページに表面活性化による常温接合プロセスについての説明有り (<http://www.lantech.co.jp/products/bond-debond/#bond-debond01>)